

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国盛电子、博时基金
会议时间	2025年9月2日 14:00-16:00
会议地点	线下
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：衡所华威在产品体系和技术方面有何优势？</p> <p>回复：衡所华威的产品体系全面覆盖基础、高性能、先进封装多个层次，在国内外众多细分应用领域处于领先地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商垄断的背景下，衡所华威立足于高性能封装的同时，积极布局先进封装领域，推动高端产品的产业化。衡所华威产品结构聚焦于高性能产品的同时，在先进封装领域不断拓展，产品终端应用涉及汽车电子、新能源、第三代半导体、工业领域、消费电子、物联网、光伏等领域，形成了较为显著的产品体系优势。衡所华威主要以封装技术演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借扎实的研发实力与丰富的实践经验，在产品配方与生产工艺等方面进行持续研发与技术攻关，实现从低端到高端产品全面覆盖的技术体系，可实现灵活快速的研发需求响</p>

应。

问题二：关于衡所华威并购的进展情况如何？

回复：上海证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 9 月 1 日召开并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

问题三：本次收购衡所华威完成后对公司业务方面的发展前景有何影响？

回复：本次交易完成后，有利于公司发挥在资金、市场、经营管理方面的协同，扩大业务规模、提高经营业绩。本次交易完成后，公司将进一步把握衡所华威的经营计划和业务方向，依据其业务特点，将衡所华威发展规划与公司发展战略深度绑定，通过资源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务协同发展，控制采购成本和资金运营成本，促进生产效率、经营水平的提升。

问题四：请问公司收购衡所华威有何战略意义？

回复：公司和衡所华威均从事半导体芯片封装材料的研发、生产和销售，主要产品均为环氧塑封料，是半导体封装的关键材料。

双方在以下多方面均有协同效应，具体如下：

（1）加速国际化布局，扩大海外优质市场份额

公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，目标客户一致。衡所华威及其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，品牌知名度高，积累了一批全球知名的半导体客户。优质客户对环氧塑封料供应商的筛选和考核标准严格，合格供应商认证周期较长，认证程序复杂。本次收购完成后，公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布局，扩大海外优质市场份额。

（2）补强产品矩阵，提升客户服务能力

基于下游封装技术、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、高性能、先进封装等三类。在当下的行业格局中，高

性能占据主流地位，而先进封装是未来的行业发展方向。本次收购完成后，公司借助衡所华威在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域“卡脖子”局面，逐步实现国产替代，打造世界级半导体封装材料企业。

（3）供应链整合，优化采购与运输成本

公司与衡所华威主要产品原材料具有高度的重合性。本次并购整合完成后，双方集中采购规模上升，优化供应链及运输管理能力，在采购端与运输方面将获得更高的议价能力及资源支持。衡所华威长期积累的满足海外客户要求的供应链，将为公司产品和市场全球化拓展提供强有力的补充和支持，提高公司国际竞争力。

（4）优化产线布局，提高生产效率

环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次交易完成后，公司将对不同生产基地的优势产品进行明确分工，各个生产基地更加专注从事细分型号产品的生产，降低生产成本，提高产线的利用效率和生产效率，提高盈利水平。

（5）整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发投入

公司与衡所华威同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺路线上具有较强的互补性和协同效应。本次交易完成后，双方研发充分整合，优势互补，提高研发速度，提升现有成果水平，同时避免重复研发，将节省的研发资源全力投入到高性能和先进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，打破国外技术垄断。

问题五：公司下游应用领域的占比情况如何？

回复：下游应用领域主要集中于消费电子、光伏、车规级半导体领域。其中，消费电子占比最高，为主要领域；光伏上半年出货量稳定，暂时摆脱了此前占比逐渐降低的趋势；车规级半导体也是重要组成部分。

注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已

	对外披露正式公告。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 2 日